(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年5月13日(13.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/039593 A1

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山本 将也 (YA-MAMOTO,Masaya) [JP/JP]; 〒615-8585 京都府 京都市

(74) 代理人: 吉田 稔 ,外(YOSHIDA,Minoru et al.); 〒 543-0014 大阪府 大阪市 天王寺区玉造元町 2番

右京区西院溝崎町 2 1 番地 ローム株式会社内 Kyoto (JP). 小畠 忍 (OBATA, Shinobu) [JP/JP]; 〒615-8585 京

都府 京都市 右京区西院溝崎町 2 1 番地 ローム株式

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/013889

B41J 2/325, 2/345

(22) 国際出願日:

2003年10月29日(29.10.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願 2002-314230 2002年10月29日(29.10.2002) (81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

3 2-1 3 0 1 Osaka (JP).

会社内 Kyoto (JP).

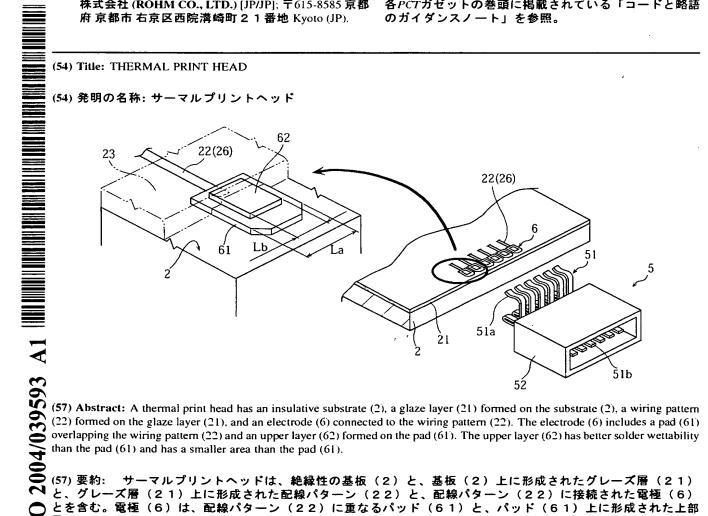
添付公開書類:

国際調査報告書

(72) 発明者; および

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ローム 株式会社 (ROHM CO., LTD.) [JP/JP]; 〒615-8585 京都 府 京都市 右京区西院溝崎町21番地 Kyoto (JP).

2 文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。



と、グレーズ層(21)上に形成された配線パターン(22)と、配線パターン(22)に接続された電極(6) とを含む。電極(6)は、配線パターン(22)に重なるパッド(61)と、パッド(61)上に形成された上部 層(62)とを含んでいる。上部層(62)は、パッド(61)よりも半田濡れ性が優れているとともに、パッド (61)よりも面積が小さい構成とされている。



ABSTRACT

A thermal print head includes an insulating board (2), a glaze layer (21) formed on the board (2), a wiring pattern (22) formed on the glaze layer (21), and an electrode (6) 5 connected to the wiring pattern (22). The electrode (6) includes a pad (61) provided on the wiring pattern (22), and an upper layer (62) formed on the pad (61). The upper layer (62) has a higher solderability than the pad (61) while also having a smaller surface area than the pad (61).

10